

2007年11月6日

# 2008年3月期 中間決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

# 2008年3月期中間(連結)業績

(単位:百万円)

	2007年3月期		2008年3月期		増減率 (%)
	中間	百分比%	中間	百分比%	
売上高	45,625	100.0	53,789	100.0	17.9%
売上総利益	5,901	12.9	8,175	15.2	38.5%
営業利益	1,550	3.4	1,836	3.4	18.5%
経常利益	1,419	3.1	1,825	3.4	28.6%
当期純利益	841	1.8	1,060	2.0	26.0%
1株当たり中間純利益	9,146.61円		10,006.16円		
R O E	10.9%		10.4%		
従業員数	574人		774人		

2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継しております。  
したがって、前中間期はコンピュータ・ネットワーク事業を含んでおりませんが、当中間期は含んでおります。

# 2008年3月期中間(連結) 資産

(単位:百万円)

科目	2007年3月期 中間	2008年3月期 中間	増減額
現預金	793	1,235	442
受取手形・売掛金	17,478	22,016	4,538
たな卸資産	16,407	17,311	904
その他流動資産	721	2,183	1,462
有形固定資産	699	1,083	384
無形固定資産	144	504	360
投資その他の資産	1,476	2,241	764
資産計	37,721	46,578	8,856

# 2008年3月期中間(連結) 負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2007年3月期 中間	2008年3月期 中間	増減額
買掛金	11,177	12,511	1,334
短期借入金	2,478	3,755	1,277
その他流動負債	2,440	5,433	2,993
長期借入金	3,000	-	3,000
その他固定負債	2,932	4,073	1,140
<b>負債計</b>	<b>22,029</b>	<b>25,774</b>	<b>3,744</b>
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	2,054	5,645	3,590
利益剰余金	11,154	12,656	1,501
評価・換算差額等	13	6	19
<b>純資産計</b>	<b>15,691</b>	<b>20,803</b>	<b>5,112</b>
<b>負債・純資産計</b>	<b>37,721</b>	<b>46,578</b>	<b>8,856</b>

# 2008年3月期中間(連結) キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2007年3月期 中 間	2008年3月期 中 間	増減額
営業キャッシュ・フロー	386	1,508	1,895
投資キャッシュ・フロー	109	501	391
財務キャッシュ・フロー	490	911	1,401
現金及び現金同等物 中間期末残高	793	1,235	442

# 2008年3月期中間(連結) 品目別売上高

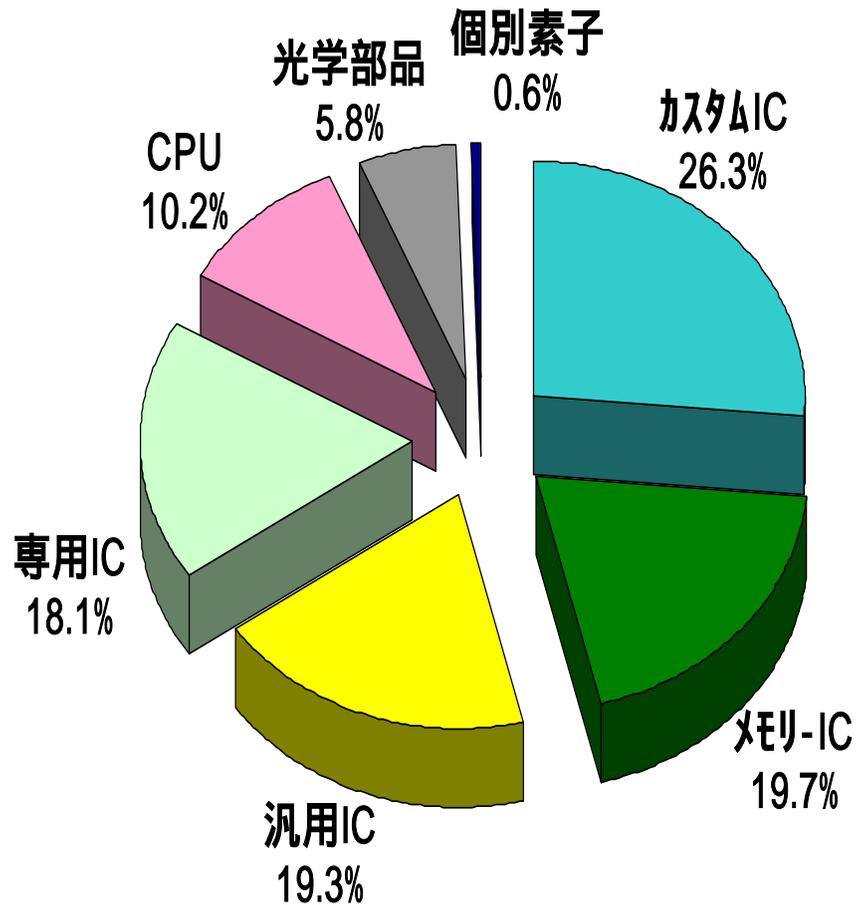
(単位:百万円)

品目	2007年3月期中間		2008年3月期中間		増減率 (%)
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	40,640	89.1	39,626	73.6	2.5
電子部品他	2,797	6.1	2,733	5.1	2.3
ソフトウェア	2,187	4.8	2,729	5.1	24.8
コンピュータ・ ネットワーク機器	-	-	8,700	16.2	-
合計	45,625	100.0	53,789	100.0	17.9

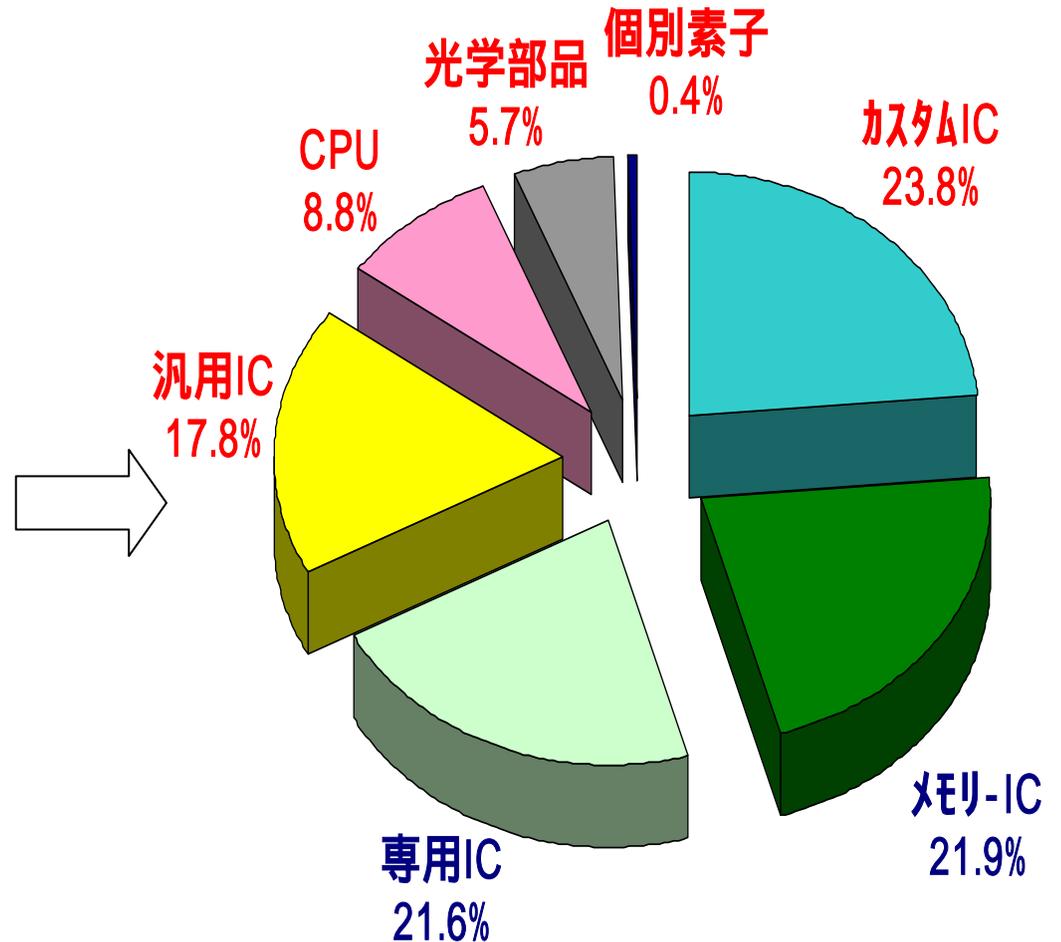
\* 品目についての説明は、P.30～ P.32をご参照ください。

# 半導体製品 品目別売上構成

< 2007年3月期中間 >



< 2008年3月期中間 >



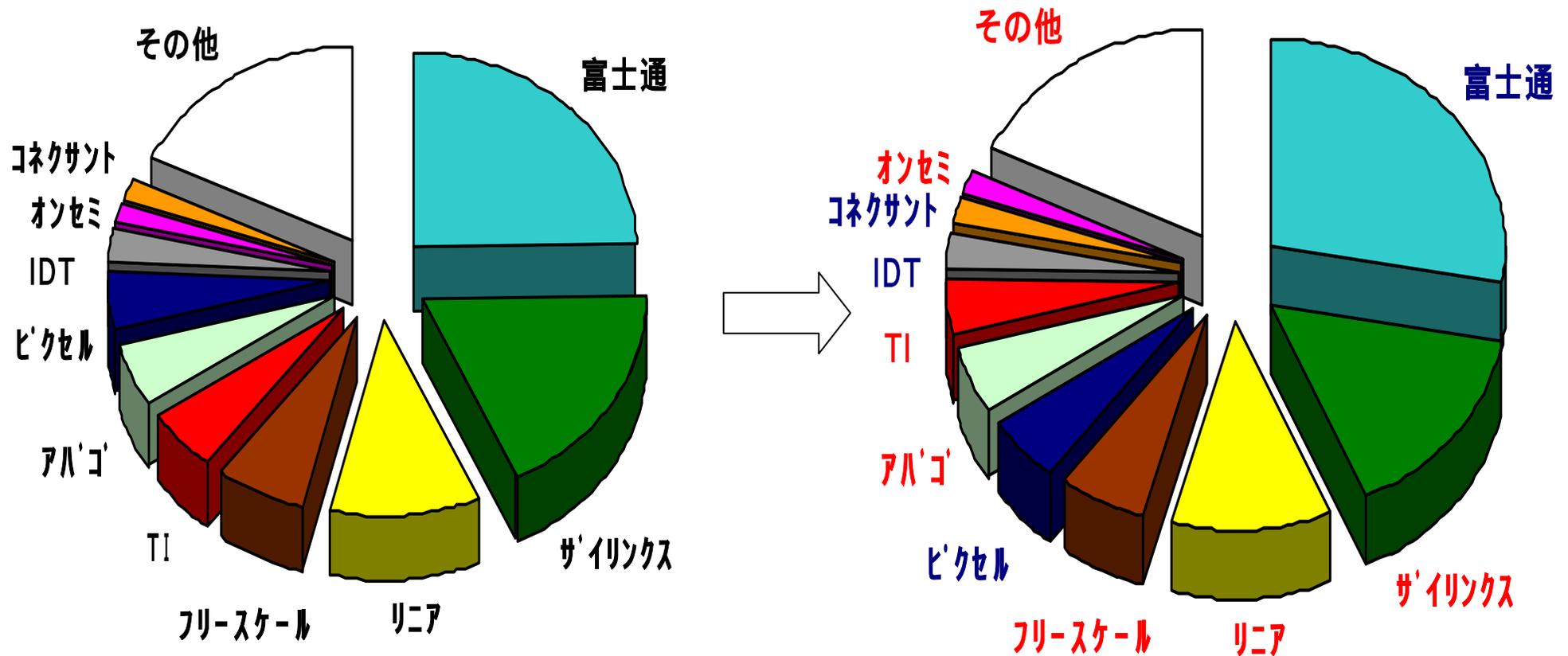
\* 品目についての説明は、P.30 P.31をご参照ください。

# 商品別売上構成

(対象:半導体製品、電子部品他)

< 2007年3月期中間 >

< 2008年3月期中間 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

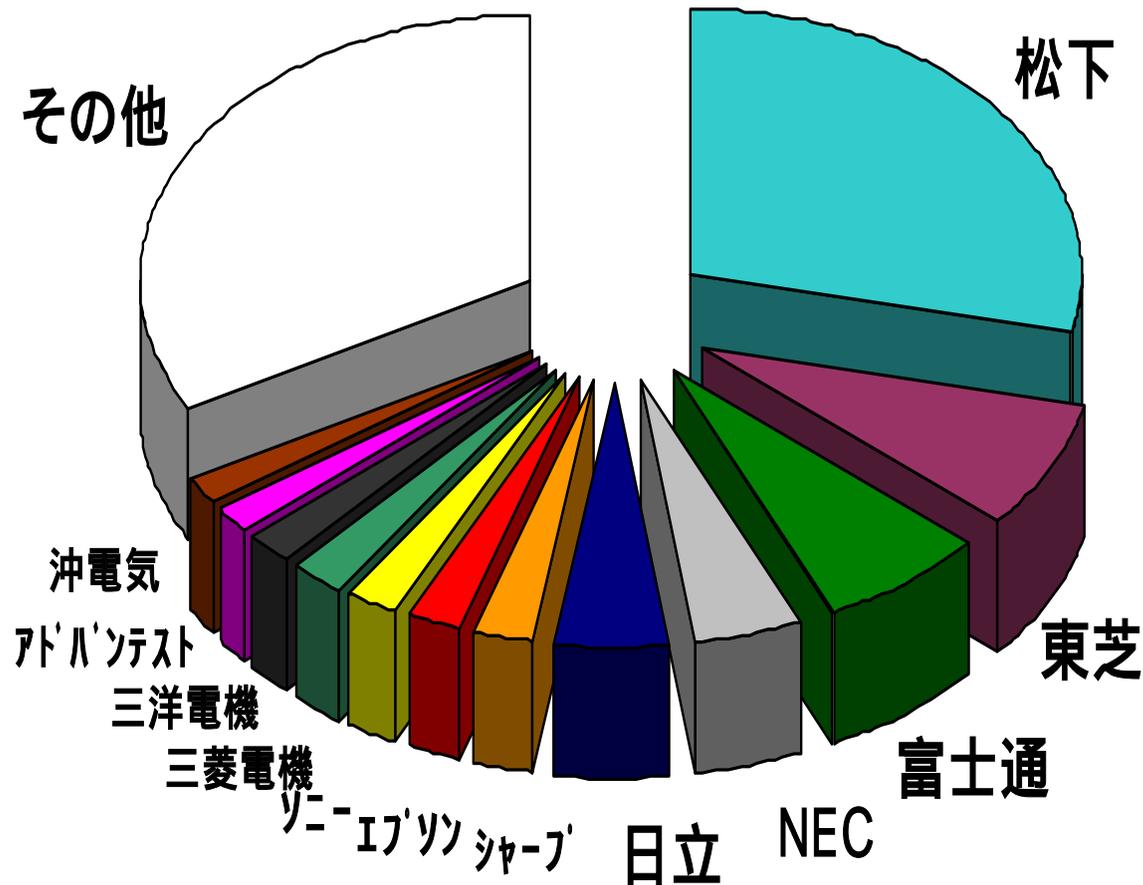
# 主要商品別売上増減要因

(対象:半導体製品、電子部品他)

仕入先名	増減率	要 因
富士通(株)	9%	民生機器を中心にフラッシュメモリ伸長
ザイリンクス社	17%	携帯電話基地局向け減少
リニアテクノロジー社	2%	民生機器(特定顧客)向け減少
フリースケール・セミコンダクタ社	12%	携帯電話(特定顧客)向け減少
ピクセルワークス社	6%	家庭用プロジェクタ向け伸長
開発ビジネス	43%	設計受託、自社商品、共に伸長

# 顧客別売上構成

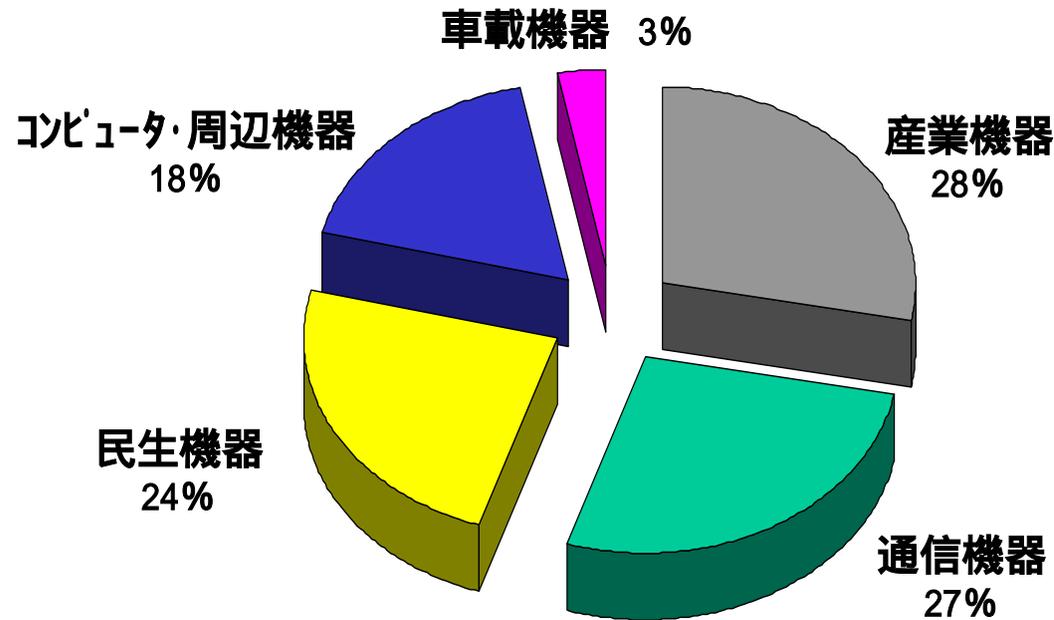
(対象:半導体製品、電子部品他)



注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

# 用途別売上構成

(対象:半導体製品、電子部品他)



用途	主なアプリケーション
産業機器	医療機器、放送機器、半導体試験装置、半導体製造装置
通信機器	携帯電話、基地局、ネットワーク機器
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、液晶・プラズマTV、DVD、携帯音楽端末
コンピュータ・周辺機器	プリンター、液晶プロジェクタ、POS、PC、メモリカード
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

# 海外ビジネスについて

## 東京エレクトロン デバイス香港

- ・ 中間売上高：42億円(受注高 43億円)

	2006年3月期 通期実績	2007年3月期 通期実績	2008年3月期 通期修正計画
売上高	28億円	64億円	80億円

# コンピュータ・ネットワーク機器

・ 中間売上高：87億円

内 訳	主要仕入先	中 間 売上高
ネットワーク機器	エクストリーム社 F5 ネットワークス社	35億円
ストレージ機器	ブロード社 エミュレックス社	52億円

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)

F5ネットワークス社

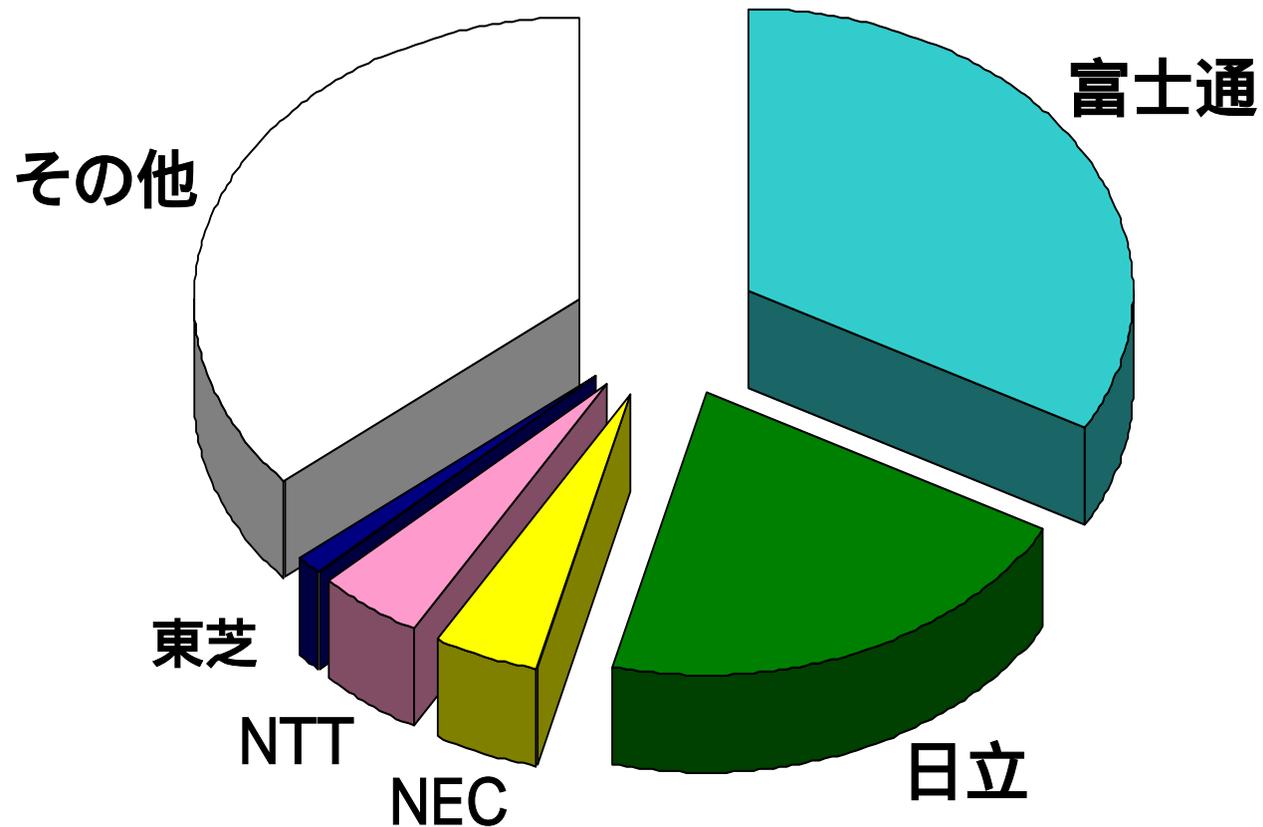


SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ

ブロード社



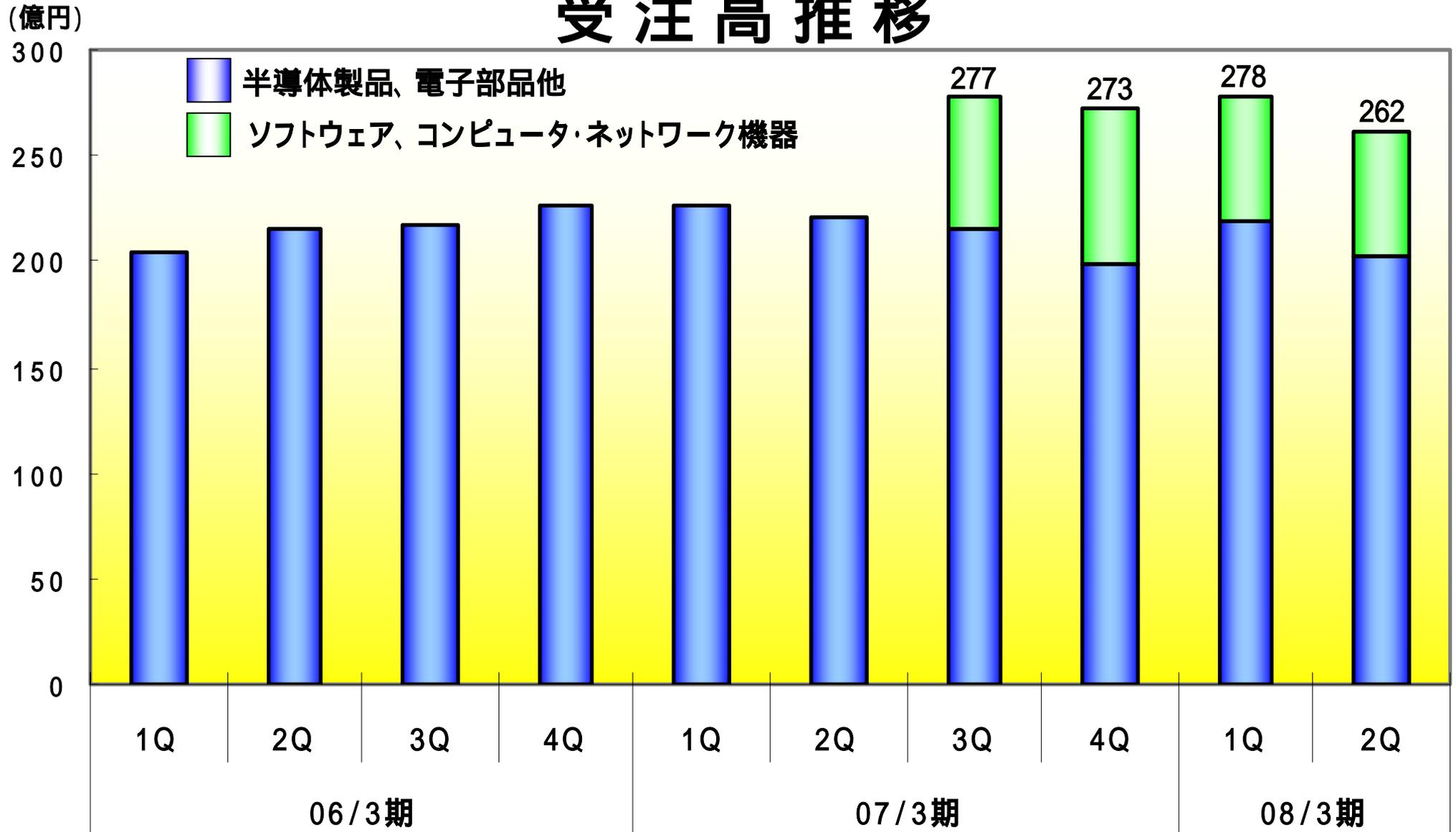
# コンピュータ・ネットワーク機器 顧客別売上構成



(注) 社名は敬称を略し、グループの略称を使用させていただいております。

# 今期の業績予想について

# 受注高推移



注)07/3期3Qより、東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継しております。  
07/3期3Qの受注高は、事業承継時(10月)の受注残高41億円を含めておりません。

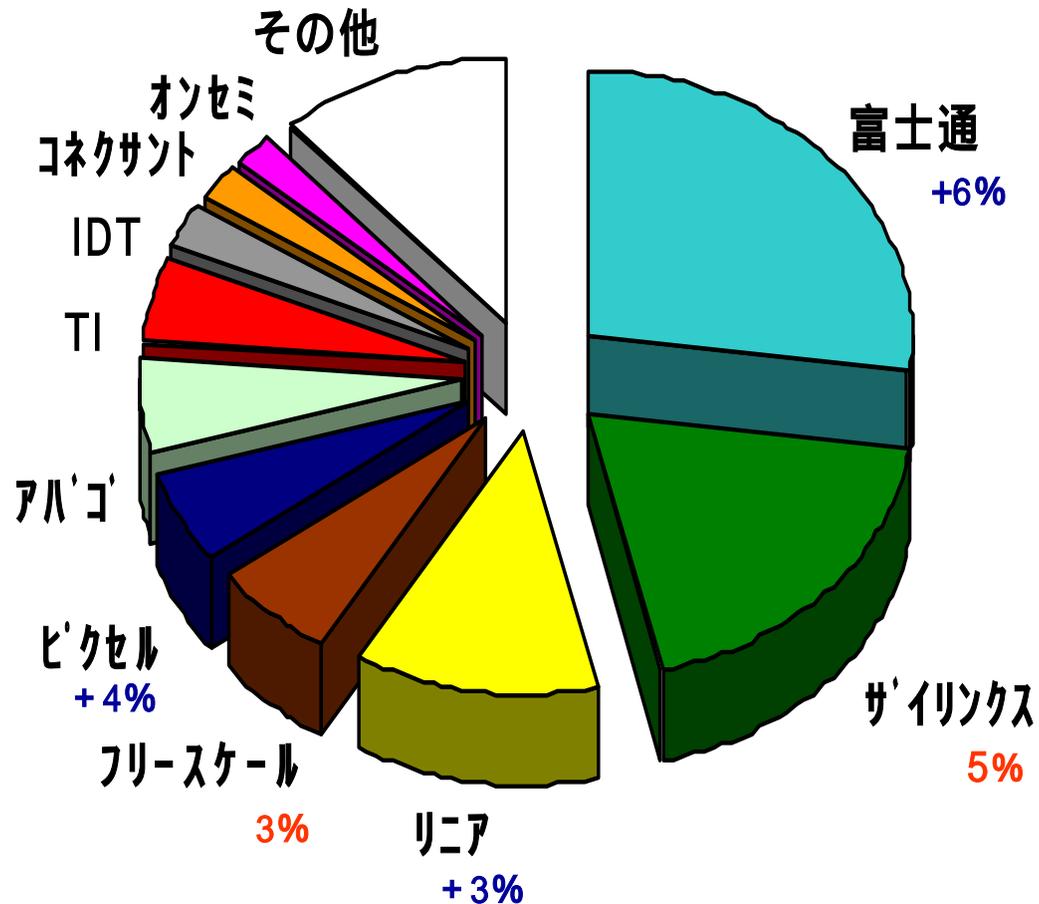
# 2008年3月期 品目別 連結売上高見込み

(単位:百万円)

品 目	2007年3月期実績		2008年3月期見込み		増減率 (%)
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	79,569	79.8	79,500	72.3	0.1
電子部品他	5,372	5.4	5,300	4.8	1.3
ソフトウェア	5,881	5.9	6,300	5.7	7.1
コンピュータ・ ネットワーク機器	8,918	8.9	18,900	17.2	111.9
合 計	99,743	100.0	110,000	100.0	10.3

2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継しているため、  
2007年3月期は下期のみ、2008年3月期は通期で、コンピュータ・ネットワーク事業が含まれております。

# 2008年3月期 半導体製品 商品別売上構成見込み



注) 上記見込みは、各仕入先の業績を示すものではありません。  
 数字は、前年比増減見込みを記載しております。  
 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

# 2008年3月期 連結 業績予想

(単位:百万円)

科目	2007年3月期 通期実績	2008年3月期 通期予想	増減率
売上高	99,743	110,000	10.3%
営業利益	3,531	4,080	15.5%
経常利益	3,245	3,800	17.1%
当期純利益	1,876	2,200	17.2%
1株当たり 当期純利益	18,957.04円	20,754.72円	
1株当たり配当金	6,000円	6,600円	

# 今期の活動方針

1. **コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア**  
    **サイト構築インテグレーションビジネスの推進**
2. **半導体製品、電子部品他**
  - ・産業機器分野への販売強化
  - ・海外事業展開の推進
3. **情報システムの再構築**

# 中期目標

< 2011年3月期 >

売上高

1,500億円

經常利益

75億円

売上高經常利益率

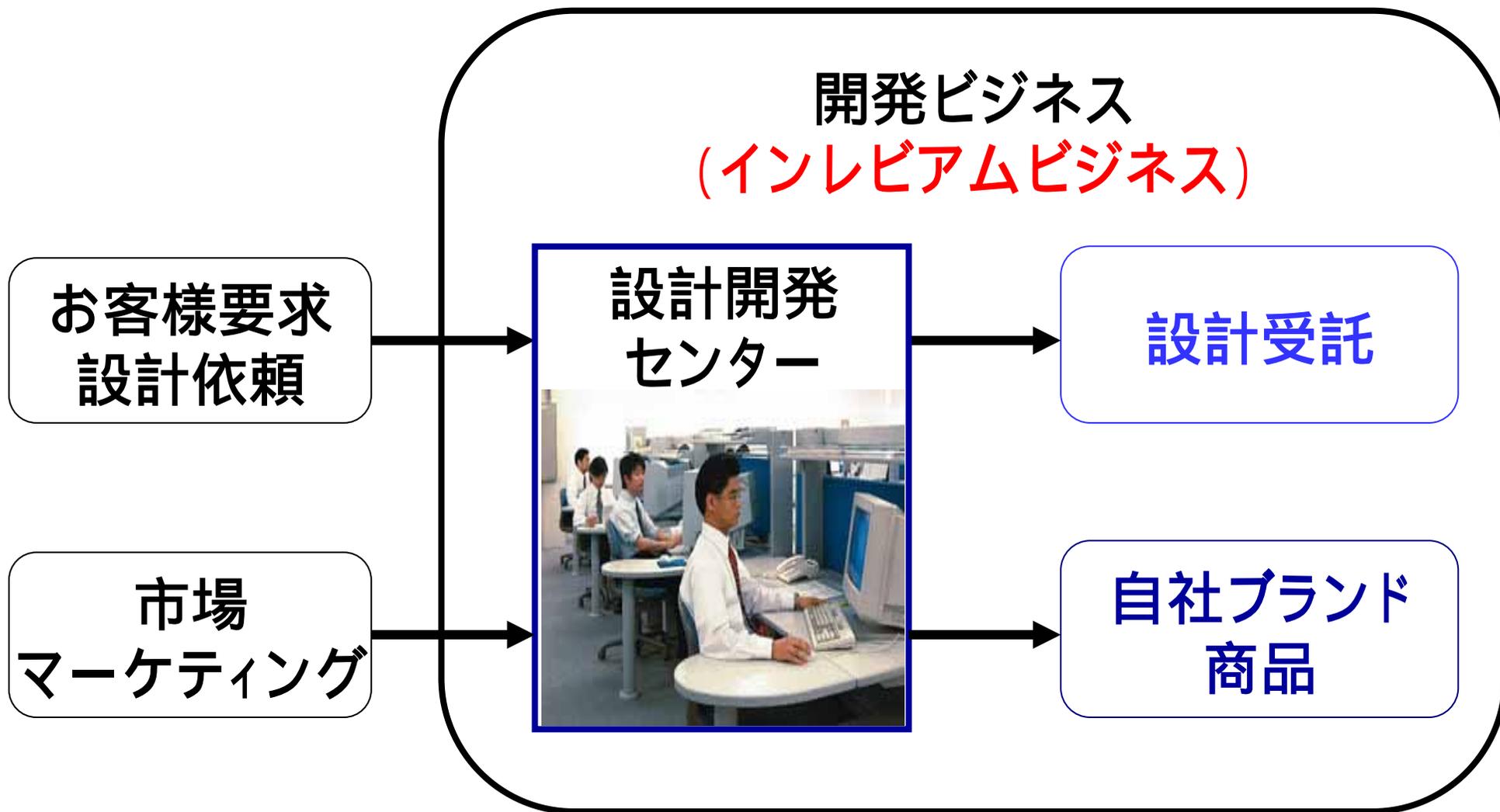
5%以上

# 開発ビジネスについて

***inrevium***

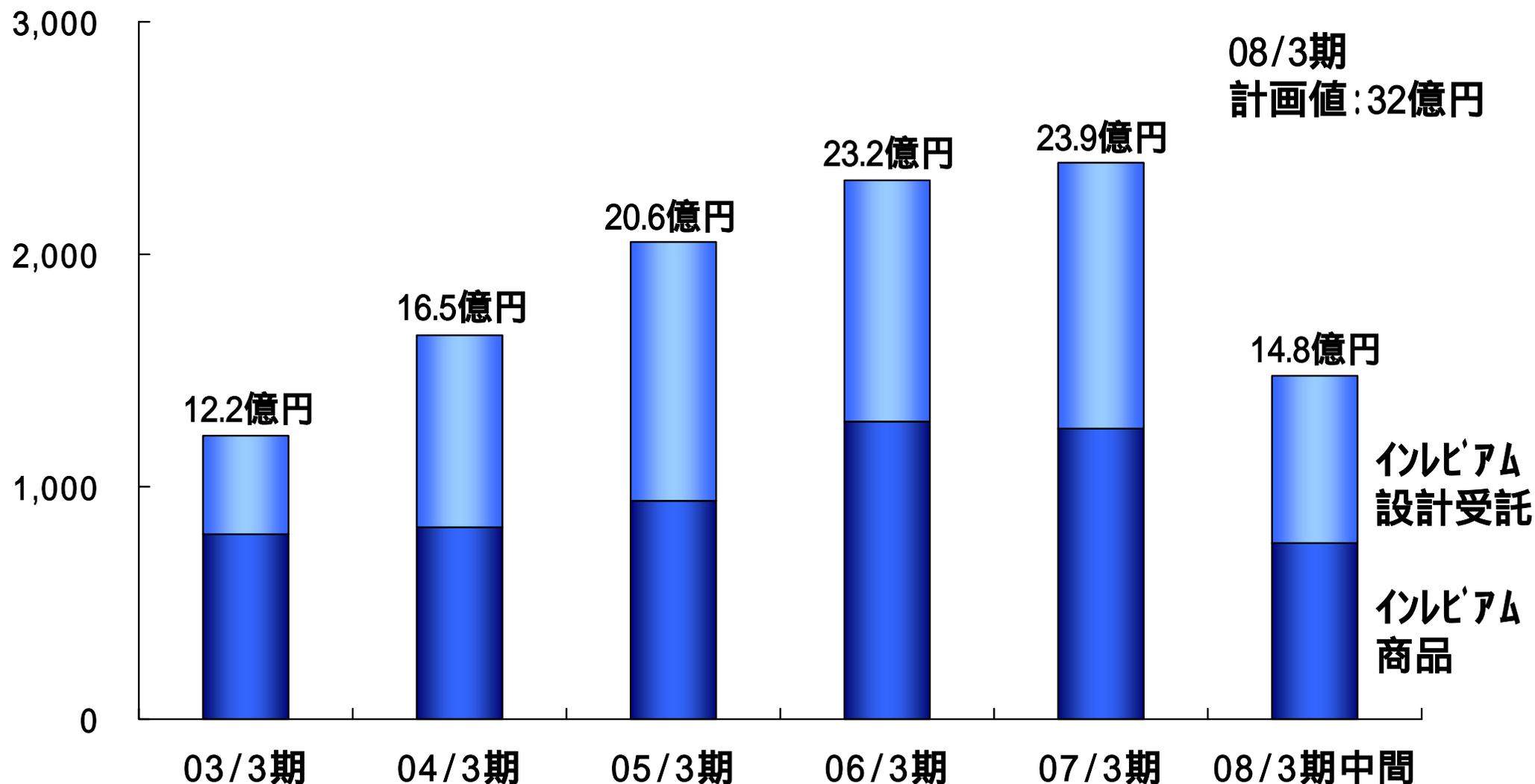
(インレビウム)

# 高付加価値事業への取組み



# インレビウム売上高推移

(百万円)



注)06/3期より連結決算を開始しており、06/3期以降は、連結売上高を記載しております。

## インレビウム商品 開発例

### 画像・信号処理用評価ボード

- ・当社取扱い商品TI社製DSPとザイリンクス社製FPGAを搭載
- ・高速データ通信が必要なシステム向け評価ボード



< 応用分野 >  
画像配信システム  
医療機器など

## インレビウム商品 開発例

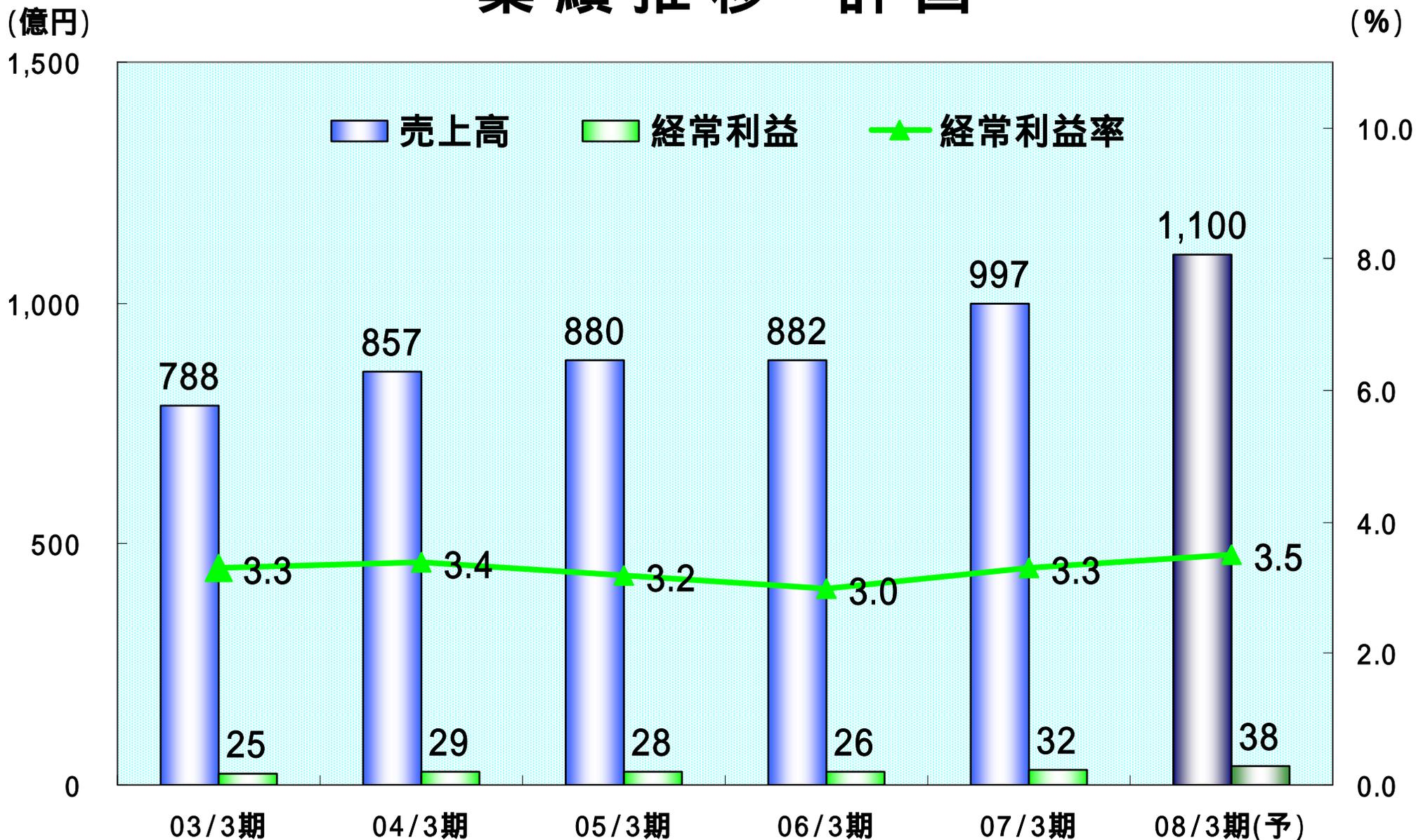
### マルチ・アプリケーション評価ボード

- ・ザイリンクス社FPGA (Virtex-5) とDDR2 SDRAMを搭載
- ・高速・大規模なデータ処理が必要なシステム開発向け評価ボード



< 応用分野 >  
薄型TV  
医療機器など

# 業績推移・計画



## 2008年3月期中間(連結) 品目別売上高

(単位:百万円)

品目	2007年3月期 品目	2007年3月期中間		2008年3月期中間		増減率 (%)
		売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	半導体製品	40,640	89.1	39,626	73.6	2.5
電子部品他	ボード製品	1,638	3.6	1,719	3.2	4.9
	一般電子部品	1,159	2.5	1,014	1.9	12.5
ソフトウェア	ソフトウェア	2,187	4.8	1,862	3.5	14.9
	-	-	-	866	1.6	-
コンピュータ・ ネットワーク機器	-	-	-	8,700	16.2	-
合計		45,625	100.0	53,789	100.0	17.9

## 2008年3月期 品目別 連結売上高見込み

(単位:百万円)

品目	2007年3月期 品目	2007年3月期実績		2008年3月期見込み		増減率 (%)
		売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	半導体製品	79,569	79.8	79,500	72.3	0.1
電子部品他	ボード製品	3,264	3.3	3,300	3.0	1.1
	一般電子部品	2,108	2.1	2,000	1.8	5.1
ソフトウェア	ソフトウェア	4,527	4.5	3,900	3.5	13.9
	-	1,354	1.4	2,400	2.2	77.3
コンピュータ・ ネットワーク機器	-	8,918	8.9	18,900	17.2	111.9
合計		99,743	100.0	110,000	100.0	10.3

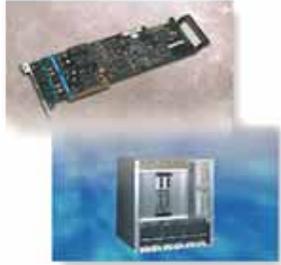
## 品目別仕入先名

	品目	主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通(株)、ザ・リンクス社
	メモリーIC	富士通(株)、IDT社、ラムトロンインターナショナル社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビームなど
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通(株)、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
電子部品他		コーセル(株)、(株)デジタル、ダイアロジック社、インビーム
コンピュータ・ネットワーク機器		エクストリーム ネットワークス社、F5 ネットワークス社、ブロード コミュニケーションズ システムズ社、エミュレックス社
ソフトウェア		マイクロソフト社、日本オラクル(株)、センセージ社、インビーム

## 用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(ザイリンクス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

# 用語説明(2)

<p>電子部品他</p>		<p>プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装したボード製品、 機器間を接続するコネクタやケーブル、電源などの電子機器には不可欠な周辺部品。</p>
<p>コンピュータ・ネットワーク機器</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器、 SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア、 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のOSなどのソフトウェア。</p>

# 資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。